

Ultimax™

FC-BGA用ビルドアップドライフィルム

NEW

Dry Film Type Build Up Material for FC-BGA Substrate

米国デュポン社と太陽インキ製造の共同開発品

Commercialized soon, Joint Development Product by DuPont and TAIYO INK MFG. CO., LTD.

特長 Features

- ロープロファイル Low profile
- 安定した密着強度 Stable peel strength
- 低CTE材・高Tg材の使用 Low CTE and High Tg material
- ハロゲンフリー・リン化合物フリー Halogen and Phosphorus free

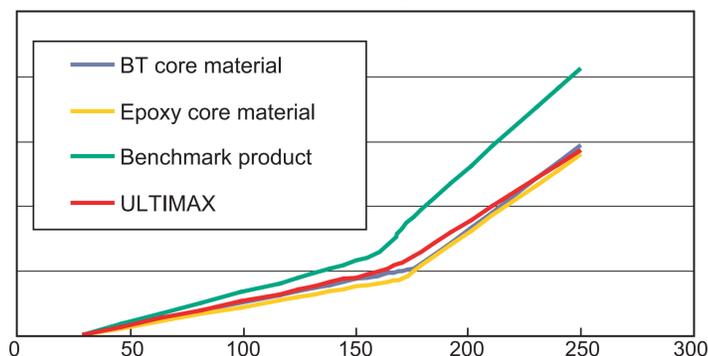
仕様 Specifications

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 膜厚 Resin thickness | 40μm (standard)- Adjustable |
| 色調 Color | White |
| 保管条件 Storage condition | Below -15°C |
| 推奨硬化条件 Recommended curing condition | 180°C, 60min |

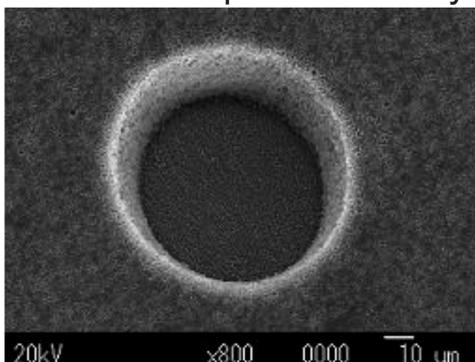
特性 Properties

| | | |
|---|-------------------------|-------|
| ガラス転移点 Tg *TMA method | 170 °C | |
| 線膨張係数 | 25-150 °C | 36ppm |
| CTE | 150-250 °C | 90ppm |
| ヤング率 Young's modulus | 4.7GPa | |
| 破壊強度 Tensile strength | 90MPa | |
| 破壊伸び率 Elongation | 4.5% | |
| ピール強度 Peel strength | Above 6N/cm | |
| 表面粗さ Surface roughness(After resin etching) | Ra: 0.2~0.3 μm | |
| 難燃性 Flamability test | UL94 V-0 相当(equivalent) | |

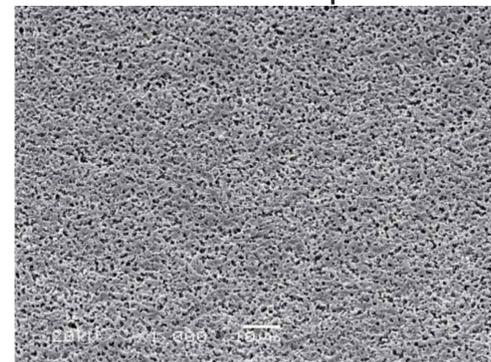
Excellent CTE matching to core material



Good laser processability



Fine surface profile



太陽インキ製造株式会社
TAIYO INK MFG. CO., LTD.